

## Imprint를 이용한 Stamp 제작방법

곽 정복, 이 상문, 나 승현

삼성전기 중앙연구소 eMD 센터

**Abstract** : PCB기판 제작에 있어서 미세패턴을 형성하기 위한 차세대 공법으로 imprint공법을 이용하여 PCB기판제작에 대한 내용입니다. imprinting을 하기 위해서 미세패턴이 형성된 Tool-foil을 이용하여 imprinting시 Via hole을 동시 가공을 함으로서, 공정 비용 절감과 공정 프로세스 단축의 효과를 볼수 있다. 하지만 대면적(405\*510size) imprint용 N-stamp제작이 쉽지 않으며, Ni-stamp가격또한 만만치 않으며, 대면적 size일수록 이형처리 또한 쉽지 않다. 이형문제와 Stamp제작 비용을 줄이기 Cu-stamp를 제작 하여, Imprint후 이형처리 하지 않으며, Stamp제작 또한 쉬우며, 가격도 싸기 때문에 그에 따른 기대효과를 간략하게 소개 하고자 한다.

**Key Words** : imprint, tool-foil, stamp